

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-028

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示

● 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）；不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 202,811,998.36 元，公司期末可供分配利润为人民币 575,627,129.02 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至本公告日，公司总股本为 201,138,646 股，扣除回购专用证券账户中股份数 102,607 股后的剩余股份总数为 201,036,039 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,113,964.29 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 10,008,325.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 32,122,289.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 15.84%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 22,113,964.29 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 10.90%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

| 项目                                   | 本年度            | 上年度            | 上上年度           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                            | 22,113,964.29  | 27,616,820.80  | 37,148,359.60  |
| 回购注销总额（元）                            | 0              | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                     | 202,811,998.36 | 250,626,202.20 | 200,160,932.53 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                  | 927,713,789.66 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                  | 86,879,144.69  |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                  | 0              |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                     | 217,866,377.70 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）             | 86,879,144.69  |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元 | 否              |                |                |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 现金分红比例（%）                                          | 39.88            |
| 现金分红比例（E）是否低于 30%                                  | 否                |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元）                                | 646,648,641.73   |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上                         | 是                |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元）                                  | 4,855,443,004.77 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）                         | 13.32            |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上                | 否                |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否                |

### 三、关于公司本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 202,811,998.36 元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式当年已实施的股份回购金额）为 32,122,289.48 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

#### 1、公司所处行业情况及特点

半导体设备行业是一个全球化程度较高的行业，受国际经济波动、半导体市场、终端消费市场需求影响，其发展往往呈现一定的周期性波动。当宏观经济和终端消费市场需求变化较大时，半导体生产厂商会调整其资本性支出规模和对半导体设备的采购计划，从而对半导体设备公司的营业收入和盈利产生影响。在全球贸易争端不断、世界经济增长放缓、国内经济下行压力加大的背景下，全球半导体设备产业呈现震荡发展态势。

#### 2、公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售业务，通过向下游公司销售光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备等产品实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体专用设备产品的销售，其他业务收入来源于设备

相关配件销售及维修服务等。

公司所处的半导体设备行业属于技术、资金密集型行业，具有产品技术升级快、研发投入大等特点。目前公司处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于新产品的研发以及市场化，进一步提升公司的产能规模和综合竞争实力，同时完善公司的产业链布局。

### 3、公司盈利水平、偿债能力及资金需求

公司经营情况和偿债能力良好。公司的资金需求主要体现在公司新产品的研发及市场化、完善公司的产业链布局等方面。

### 4、公司现金分红水平较低的原因

综合考虑公司所处行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案，以保障公司的可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

#### （二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2024 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势等多种因素的影响。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

#### （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，进一步推动盈利水平的提升，并严格按照相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

2025年4月25日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：“公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。”

## 四、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年4月26日